

## 科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號

聯絡人：張庭軒 助理研究員

聯絡電話：02-2737-7437

傳真：--

電子郵件：tschang@most.gov.tw

受文者：銘傳大學

發文日期：中華民國106年12月12日

發文字號：科部工字第1061011848號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、如文

主旨：本部推動「矽光子及積體電路」專案研究計畫，自即日起接受申請，請於107年3月14日(星期三)前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、本專案計畫期以落實產學研密切結合之目標，故計畫團隊須邀請業界及法人單位參與規劃及執行，並於申請計畫時提供附件1(業界合作意願書及合作內容說明)及附件2(法人單位合作內容說明);另計畫書中須規劃研究項目及應用項目，且須針對各項核心技術，說明目前及計畫預定達成之技術成熟度(如附件3)及成果指標說明(如附件4);並請將附件1-4置於計畫書表CM03研究計畫內容最後。
- 二、本專案計畫須規劃前二年完成核心技術開發與系統晶片架構設計，第三年完成系統晶片製作與性能優化，第四年完成系統展示並能將技術與廠商進行後續之應用與推廣。
- 三、本專案計畫申請以單一整合型計畫為限，計畫書總計畫及所有子計畫全部書寫於一份計畫書，每一整合型計畫需含總計畫與至少3項子計畫，總計畫主持人須同時主持1

項子計畫，僅總計畫主持人列入本部專題研究計畫件數計算。

四、本專案計畫之執行期程自107年8月1日開始。

五、本公告計畫經費係屬專款專用，恕不受理申覆。

六、本專案計畫相關申請規範與研究範疇等細節說明，請詳閱本部網站()-動態資訊(計畫徵求)或工程司網站()-公告事項。

七、本案聯絡人：

(一)相關計畫內容疑問，請洽本部工程司張庭軒先生，電話：(02)2737-7437。

(二)有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，電話：0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共304單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司

部長陳良基

【簽辦紀錄 - NO.178335】

秘書處-外文處理者, 藍淑貞 (2017-12-13 12:20, 附件異動)

秘書處-登記桌, 賴數淑 (2017-12-13 14:14, 分文)

研究發展處-登記桌, 高維翎 (2017-12-13 15:40, 分文)

研究發展處-研究暨評量組-一般職員, 李心怡 (2017-12-13 16:42, 陳核): 一、本計畫申請, 意者請詳閱徵求公告計畫重點說明, 於107年3月7日(星期三)前於線上提出申請、提供附件至研發處, 並致電分機2651確認, 以利彙整辦理。

二、擬呈核後公告, 並另函轉知資訊學院。

三、敬會產學暨推廣處。

研究發展處-研究暨評量組-組長, 李孟真 (待處理)